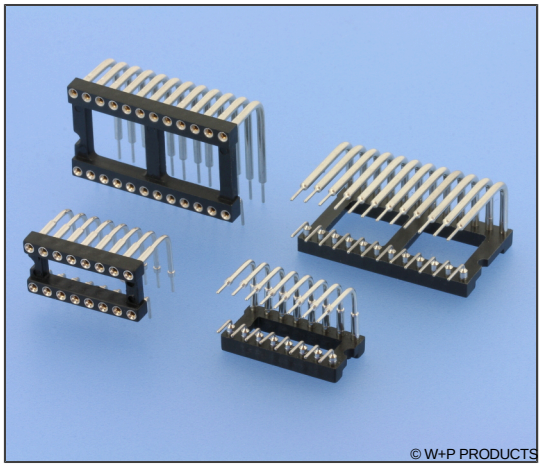
181

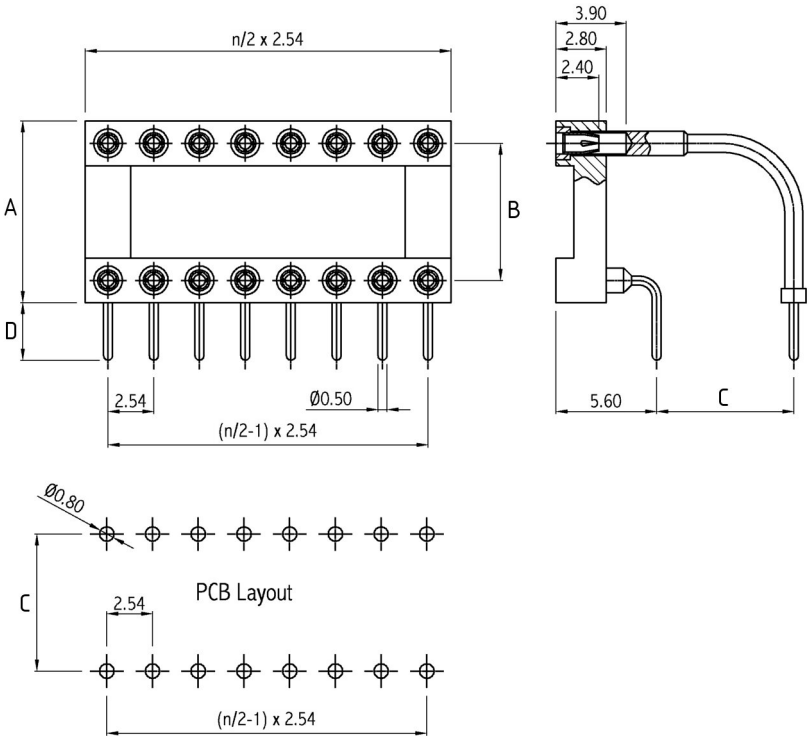
IC-Fassungen für LED-Anzeigen
IC Sockets for LED Displays

Technische Daten / ***Technical Data***

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options, over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Für Rundstifte Ø0,40~0,56mm
oder für Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
Accepts Ø0.40~0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



n	Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
10	2	7.6	5.08	5.08	3.2
04-10	7 closed frame	10.1	7.62	2.54	
14/16					
18-24	3			7.62	
28					
16	6	17.7	15.24	7.62	4.2
24					
28					
32					
36					
40/42					
48-52					

Series	*Contacts* *	*Type* *	*Sleeve Plating*	*Clip Plating* *	*Leadfree (Optional)* *
181	**16**	**3**	**50**	**00**	**LF21**
	04-10/14-24/28/32/ 36/40/42/48/50/52 DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle *DIP Spacing options pl. see table*	**2** A=7.6 B=5.08 C=5.08 D=3.2 **7** A=10.1 B=7.62 C=2.54 D=3.2 Type 7: Geschlossener ISK *Type 7: Closed frame* **3** A=10.1 B=7.62 C=7.62 D=3.2 **6** A=17.7 B=15.24 C=7.62 D=4.2	**50** Hülse verzinnt *Tin plated sleeve*	**00** Vergoldet *Gold plated* **30** 0,75µm Au	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree without RoHS exemption 6c*

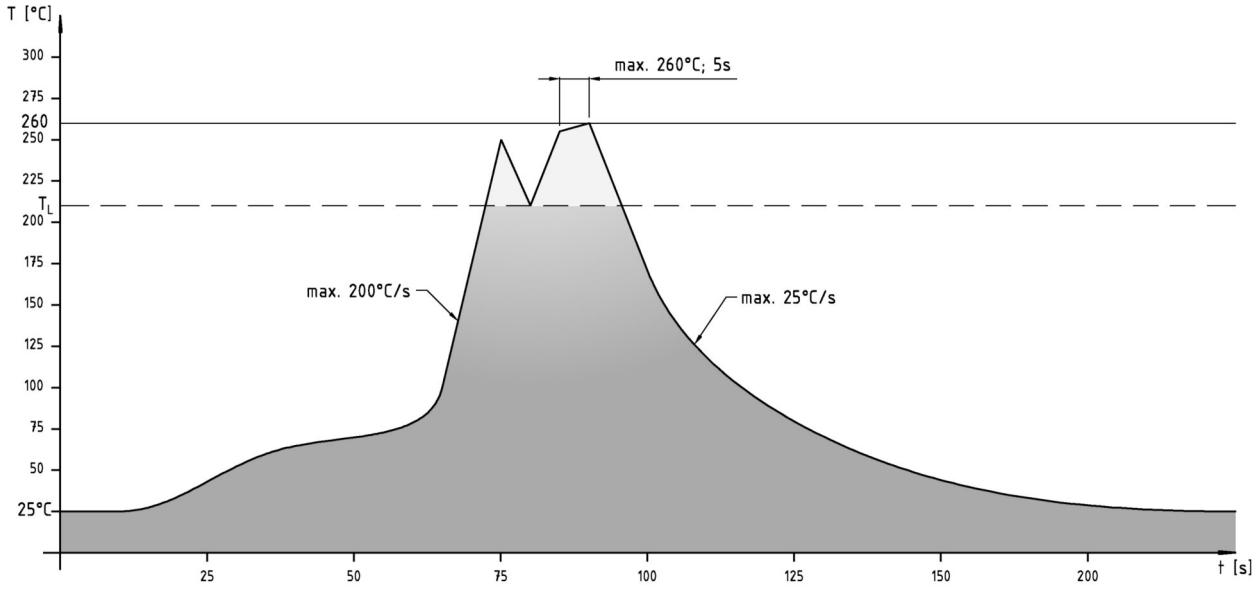
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an* ***order example*** *-*
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

